

嘉兴斯达半导体股份有限公司首次公开发行股票并上市招股意向书摘要

(上接 D11版)

截至本招股意向书签署日,发行人及其子公司拥有13处房屋所有权,具体情况如下:

序号	权证编号	权利人	房地坐落	规划用途	建筑面积(m ²)	他项权利
1	嘉房权证南湖区字第00521989号	斯达股份	嘉兴市南湖区科兴路988号	工业	6,304.68	已抵押
2	嘉房权证南湖区字第00521990号	斯达股份	嘉兴市南湖区科兴路988号	工业	1,670.67	已抵押
3	嘉房权证南湖区字第00582522号	斯达股份	嘉兴市南湖区科兴路988号6号楼	工业	64.17	已抵押
4	嘉房权证南湖区字第00582130号	斯达股份	嘉兴市南湖区科兴路988号4号楼	工业	5,136.23	已抵押
5	嘉房权证南湖区字第00582129号	斯达股份	嘉兴市南湖区科兴路988号5号楼	工业	3,574.52	已抵押
6	嘉房权证南湖区字第0067382号	斯达股份	嘉兴市南湖区科兴路988号3号楼	工业	914.52	已抵押
8	嘉房权证南湖区字第0067383号	斯达股份	嘉兴市南湖区科兴路988号7号楼	工业	2724.1	已抵押
9	嘉房权证南湖区字第0067384号	斯达股份	嘉兴市南湖区科兴路988号7号楼	工业	21,736.23	已抵押
10	南甬市权证南甬字第00335592号	浙江各监	宁波市海曙区文苑路7号	科研办公	5333.1	-
11	南甬市权证南甬字第00335591号	浙江各监	宁波市海曙区文苑路7号	科研办公	7,521.04	-
12	南甬市权证南甬字第00335590号	浙江各监	宁波市海曙区文苑路7号	科研办公	2,611.62	-
13	沪(2017)嘉定区不动产权第020936号	上海道之	嘉定区清路街85号	工厂	20,884.1	已抵押

公司已按照国家房地产管理有关规定,办理了房地产权登记手续,取得了房地产权证书,公司取得上述房产所履行的程序符合有关法律的规定,不存在因发生质量、安全事故或违反建设工程方面的法律、法规受到行政处罚的情形。公司各项房屋所有权取得符合有关法律、法规的规定。

截至报告期末,发行人及其子公司主要设备(净值200万元以上)具体情况如下:

序号	设备名称	权利人	设备净值(万元)	用途
1	离心机	斯达股份	299.23	生产设备
2	真空回流炉	斯达股份	234.72	生产设备
3	真空回流炉	斯达股份	269.71	生产设备
4	真空回流炉	上海道之	329.12	生产设备
5	真空回流炉	上海道之	328.18	生产设备
6	离子注入机	上海道之	615.55	生产设备
7	真空回流炉	上海道之	367.16	生产设备
8	真空回流炉	上海道之	366.93	生产设备

2. 租赁的房屋建筑物

截至本招股意向书签署日,发行人及其子公司签署并正在履行的租赁合同具体情况如下:

序号	承租人	出租人	位置	租赁面积(m ²)	租赁期限	租金	用途
1	斯达股份	王晓	北京市门内大街世纪中心A座1802	692.1	2019.06.01-2021.05.31	5,500元/月	办公
2	斯达股份	何映	绍兴市龙南街道108号秀城大厦21-14	51.42	2018.11.01-2021.11.01	1,900元/月	办公
3	斯达股份	胡强	济南市历下区经一路-经一路北侧大明湖旁A座504室	49.40	2019.08.07-2022.08.06	2,500元/月	办公
4	斯达股份	尹争	江苏省南京市江宁区秣陵街道天元观邸158号嘉誉天元居01幢534室	68.45	2019.10.15-2022.10.15	3,080元/月	办公
5	斯达股份	叶桂枝	南京市青奥会及国际软件园1号东和大厦B座A座505号	89	2019.01.24-2023.01.23	2,860元/月	办公
6	斯达股份	郝月光	山东省济南市李村经济开发区47号(百通大厦)211605户	39.2	2019.09.15-2022.09.14	30,000元/年	办公
7	斯达股份	深圳市汇潮物业管理有限公司	深圳市宝安区西乡街道金海路1804号	129	2019.03.01-2022.02.28	9,804元/月	办公
8	斯达欧洲	Tarchini Real Estate SA	CMC, Map. 540 a Castelano, 8 primo piano, Swiss	201	2019.07.01-2021.06.30	25,145瑞士法郎/年	办公
9	斯达欧洲	MIP Immobilien-Verwaltungs GmbH & Co. KG	Steinstraße 19-21 Wittenbergstraße 32-40 in 90419 Nürnberg, Germany	240	2015.07.15-2022.07.14	65欧元/平方英尺/月	办公、实验室

公司及其境内子公司租赁使用的7处房产中,5处租赁房产的出租人已取得相应的房屋所有权证书,合计建筑面积约317.28平方米;另有2处租赁房产的出租人未能提供房屋的权属证明,合计建筑面积约178.4平方米。

前述2处未取得房屋所有权的租赁房产具体情况如下:

序号	承租人	出租人	位置	租赁面积(m ²)	未取得产权证原因
1	发行人	胡强	济南市历下区经一路-经一路北侧大明湖旁秀城大厦A座504室	49.40	出租人购买房屋后,尚未办理取得房屋产权证
2	发行人	深圳市汇潮物业管理有限公司	深圳市宝安区西乡街道金海路1804号	129	该房屋系建立在集体用地上的小产权房,未能取得房屋产权证。房屋所在地深圳市宝安区西乡街道金海路1804号,系由汇潮物业管理有限公司(以下简称“汇潮物业”)向汇潮物业管理有限公司取得了登记备案表的(房屋租赁合同),租赁期限自2014年1月至2028年12月

公司7处租赁房屋均为合法建筑,除公司向深圳市汇潮物业管理有限公司租赁的面积为129m²的房屋系建立在集体用地上的小产权房,其他租赁房屋不涉及集体建设用地或划拨用地。

对于出租方未能提供房屋权属证明的租赁房产,公司及其下属子公司自租赁上述房屋使用以来,未因此发生任何纠纷或受到任何政府部门的调查、处罚,该等房屋未取得房屋权属证明的情况未对发行人及其下属子公司开展正常经营业务造成不利影响。发行人的主营业务系以IGBT为主的功率半导体芯片和模块的设计、研发、生产,并以IGBT模块形式对外实现销售,其租赁房屋主要系办公用途,搬迁不会对经营业务造成重大不利影响,公司及其下属子公司存在的上述租赁瑕疵对业务的情形,不会对本次发行上市构成实质性法律障碍。

为此,公司的实际控制人出具承诺,若因发行人及/或其子公司所租赁房屋存在权属瑕疵或相关租赁合同未办理租赁登记手续而导致发行人及/或其子公司所租赁房屋被拆除或拆迁,相关租赁合同被认定无效或出现任何纠纷,发行人及/或其子公司因此受到主管部门处罚,并因此给发行人及/或其子公司造成任何经济损失,实际控制人同意就发行人及/或其子公司实际遭受的经济损失进行全额现金补偿。据此,发行人及其境内子公司未就其房屋租赁相应办理登记备案,不会影响房屋租赁合同的效力,不会对发行人生产经营造成重大不利影响,亦不会对本次发行上市构成实质性法律障碍。

(二) 无形资产

1. 土地使用权

截至本招股意向书签署日,发行人及其子公司拥有5宗土地使用权,具体情况如下:

序号	权证编号	权利人	房地坐落	用途	使用面积(m ²)	终止日期	他项权利
1	嘉房权证南湖区字第00521989号	斯达股份	科兴路988号(嘉兴科技城)	工业用地	18,658.70	2055.12.31	已抵押
2	嘉房权证南湖区字第00521990号	斯达股份	科兴路988号(嘉兴科技城)	工业用地	34,214.80	2055.12.31	已抵押
3	嘉房权证南湖区字第00582130号	斯达股份	科兴路988号(嘉兴科技城)	工业用地	17,741.50	2055.12.31	已抵押
4	南甬市权证南甬字第05410号	浙江各监	海曙区文苑路7号	科研办公用地	9,685.00	2060.01.13	-
5	沪(2017)嘉定区不动产权第020936号	上海道之	嘉定区清路街85号	工业用地	19,879.8	2063.04.10	已抵押

注:上述土地均发行人自购取得,第1、2、3项土地由斯达股份质押给交通银行浙江分行,以获取银行授信额度;第5项由上海道之质押给中国银行南湖支行,以获取银行授信额度。

上述各项土地使用权的取得情况及履行的程序如下:

(1)斯达股份的土地使用权取得情况
2005年12月20日,公司与嘉兴市国土资源局签署了嘉土让合[2005]043号《国有土地使用权出让合同》,公司受让位于南湖区余新镇亚中路西侧总面积为70,815平方米的土地。公司已支付完毕前述《国有土地使用权出让合同》项下的全部价款。2006年3月9日,公司取得了嘉兴市人民政府核发的嘉南湖国用(2006)第005-00972号《国有土地使用证》。
公司前述受让《国有土地使用证》项下的地块被拆分为三块地并已于2015年9月25日取得了嘉兴市人民政府核发的三块土地《国有土地使用证》。(2)浙江各监土地使用权取得情况
2009年12月7日,海宁市国土资源局与浙江道之签署了合同编号为3304812009A21186的《国有建设用地使用权出让合同》,浙江道之受让位于市区海大道南、康华医院南侧2#总面积为9,685平方米的土地。浙江道之已支付完毕前述《国有建设用地使用权出让合同》项下的全部价款。

2011年8月19日,浙江道之取得了海宁市人民政府核发的海南国用(2011)第07911号《国有土地使用证》。

2015年2月13日,浙江各监与土地使用权原权利人浙江道之签订了《房产买卖契约》,受让该宗土地使用权及地上相应房产。
2015年6月1日,浙江各监取得了海宁市人民政府核发的海国用(2015)第05410号《国有土地使用证》。(3)上海道之的土地使用权取得情况
2013年1月18日,上海道之与上海市嘉定区规划和土地管理局签署了沪嘉规土(2013)出合同第11号(1.0版)《上海市国有建设用地使用权出让合同》,上海道之受让位于嘉定区外冈镇(外1208地块)总面积为19,879.80平方米的土地。上海道之已支付完毕前述《国有土地使用权出让合同》项下的全部价款。

目前上海道之已经取得了上海市不动产登记局核发的沪(2017)嘉字不动产权第020936号《不动产权证书》。

2. 专利权

截至本招股意向书签署日,发行人及其子公司拥有的专利权共99项,其中12项存在质押。具体情况如下:

序号	专利类别	专利号	专利名称	专利权人	申请日期	公告日期	取得方式	他项权利
1	发明	ZL200910087410.1	新型直驱电机驱动系统及其控制方法	斯达股份	2009.04.02	2011.05.11	原始取得	无
2	发明	ZL200910087411.6	一种用于功率半导体器件的封装结构	斯达股份	2009.04.02	2011.08.24	原始取得	无
3	发明	ZL200910087414.X	一种用于功率半导体器件的封装结构	斯达股份	2009.04.02	2011.05.25	原始取得	无
4	发明	ZL200910087413.5	一种用于功率半导体器件的封装结构	斯达股份	2009.04.02	2012.05.30	原始取得	无
5	发明	ZL200910087415.4	一种用于功率半导体器件的封装结构	斯达股份	2009.04.02	2012.05.30	原始取得	无
6	发明	ZL200910102247.3	一种用于功率半导体器件的封装结构	斯达股份	2009.09.10	2012.05.30	原始取得	无
7	发明	ZL201010530402.2	一种用于功率半导体器件的封装结构	斯达股份	2010.11.04	2013.01.09	原始取得	无
8	发明	ZL201010550801.4	一种用于功率半导体器件的封装结构	斯达股份	2010.11.10	2012.07.18	原始取得	无
9	发明	ZL201110446660.9	一种用于功率半导体器件的封装结构	斯达股份	2011.12.29	2014.05.14	原始取得	无
10	发明	ZL201010543788.X	一种用于功率半导体器件的封装结构	斯达股份	2010.11.15	2013.08.11	原始取得	无
11	发明	ZL201110154937.4	一种用于功率半导体器件的封装结构	斯达股份	2011.05.24	2013.03.20	原始取得	无
12	发明	ZL201010033263.3	一种用于功率半导体器件的封装结构	斯达股份	2010.01.24	2012.07.27	原始取得	无
13	发明	ZL201410033300.0	一种用于功率半导体器件的封装结构	斯达股份	2014.01.24	2016.08.24	原始取得	无
14	发明	ZL201410033918.0	一种用于功率半导体器件的封装结构	斯达股份	2014.01.24	2016.08.24	原始取得	无
15	发明	ZL201410034080.5	一种用于功率半导体器件的封装结构	斯达股份	2014.01.24	2016.11.23	原始取得	无
16	发明	ZL201410033419.7	一种用于功率半导体器件的封装结构	斯达股份	2014.01.24	2017.06.06	原始取得	无
17	发明	ZL201410033389.X	一种用于功率半导体器件的封装结构	斯达股份	2014.01.24	2017.05.03	原始取得	无
18	发明	ZL201410033446.4	一种用于功率半导体器件的封装结构	斯达股份	2014.01.24	2017.02.01	原始取得	无
19	发明	ZL201410034014.5	一种用于功率半导体器件的封装结构	斯达股份	2014.01.24	2017.02.01	原始取得	无
20	发明	ZL201410034557.7	一种用于功率半导体器件的封装结构	斯达股份	2014.01.25	2017.01.04	原始取得	质押
21	发明	ZL201410034556.6	一种用于功率半导体器件的封装结构	斯达股份	2014.01.25	2017.02.08	原始取得	质押
22	实用新型	ZL200920196140.5	一种用于功率半导体器件的封装结构	斯达股份	2009.09.10	2010.05.19	原始取得	无
23	实用新型	ZL201020572513.7	一种用于功率半导体器件的封装结构	斯达股份	2010.10.22	2011.07.06	原始取得	无
24	实用新型	ZL201020605280.0	一种IGBT器件结构	斯达股份	2010.11.15	2011.13.05	原始取得	无
25	实用新型	ZL201020613969.3	一种用于功率半导体器件的封装结构	斯达股份	2010.11.11	2011.11.02	原始取得	无
26	实用新型	ZL2011120167407.5	一种用于功率半导体器件的封装结构	斯达股份	2011.05.24	2012.01.18	原始取得	无
27	实用新型	ZL2011120562050.0	一种用于功率半导体器件的封装结构	斯达股份	2011.12.29	2012.08.12	原始取得	无
28	实用新型	ZL201112056803.6	一种用于功率半导体器件的封装结构	斯达股份	2011.12.23	2012.11.07	原始取得	无
29	实用新型	ZL201202060908.6	一种用于功率半导体器件的封装结构	斯达股份	2012.06.01	2012.12.26	原始取得	无
30	实用新型	ZL201202021548.8	一种用于功率半导体器件的封装结构	斯达股份	2012.06.05	2012.12.26	原始取得	无
31	实用新型	ZL201202061679.6	一种用于功率半导体器件的封装结构	斯达股份	2012.06.05	2012.12.26	原始取得	无
32	实用新型	ZL201202021617.7	一种用于功率半导体器件的封装结构	斯达股份	2012.06.05	2012.12.26	原始取得	无
33	实用新型	ZL201410044711.2	一种用于功率半导体器件的封装结构	斯达股份	2014.01.24	2014.08.13	原始取得	无
34	实用新型	ZL201410044717.2	一种用于功率半导体器件的封装结构	斯达股份	2014.01.24	2014.07.30	原始取得	无
35	实用新型	ZL201410044781.X	一种用于功率半导体器件的封装结构	斯达股份	2014.01.24	2014.07.30	原始取得	无
36	实用新型	ZL201410044784.3	一种用于功率半导体器件的封装结构	斯达股份	2014.01.24	2014.07.30	原始取得	无
37	实用新型	ZL201410044918.1	一种用于功率半导体器件的封装结构	斯达股份	2014.01.24	2014.08.13	原始取得	无
38	实用新型	ZL201410044967.5	一种用于功率半导体器件的封装结构	斯达股份	2014.01.24	2014.08.13	原始取得	无
39	实用新型	ZL201410044553.8	一种用于功率半导体器件的封装结构	斯达股份	2014.01.24	2014.08.13	原始取得	无
40	实用新型	ZL201410045458.4	一种用于功率半导体器件的封装结构	斯达股份	2014.01.24	2014.07.30	原始取得	无
41	实用新型	ZL201410045476.2	一种用于功率半导体器件的封装结构	斯达股份	2014.01.25	2014.07.30	原始取得	无
42	实用新型	ZL201410045503.6	一种IGBT芯片结构	斯达股份	2014.01.24	2014.07.30	原始取得	无
43	实用新型	ZL201410045520.8	一种用于功率半导体器件的封装结构	斯达股份	2014.01.24	2014.07.30	原始取得	无
44	实用新型	ZL201410044557.5	一种用于功率半导体器件的封装结构	斯达股份	2014.01.24	2014.07.30	原始取得	无
45	实用新型	ZL201410045634.4	一种用于功率半导体器件的封装结构	斯达股份	2014.01.24	2014.07.30	原始取得	无
46	实用新型	ZL201410046324.4	一种用于功率半导体器件的封装结构	斯达股份	2014.01.25	2014.07.30	原始取得	无
47	实用新型	ZL201410046329.9	一种用于功率半导体器件的封装结构	斯达股份	2014.01.25	2014.07.30	原始取得	无
48	实用新型	ZL201410046966.6	一种用于功率半导体器件的封装结构	斯达股份	2014.01.25	2014.10.08	原始取得	无
49	实用新型	ZL201410046966.6	一种用于功率半导体器件的封装结构	斯达股份	2014.01.25	2014.10.08	原始取得	无
50	实用新型	ZL201502027934.17	一种用于功率半导体器件的封装结构	斯达股份	2015.05.04	2015.12.16	原始取得	质押
51	实用新型	ZL201502027919.7	一种用于功率半导体器件的封装结构	斯达股份	2015.05.04	2015.08.26	原始取得	质押
52	实用新型	ZL201502027928.8	一种用于功率半导体器件的封装结构	斯达股份	2015.05.04	2015.08.19	原始取得	质押
53	实用新型	ZL201502027929.7	一种用于功率半导体器件的封装结构	斯达股份	2015.05.04	2015.08.26	原始取得	质押
54	实用新型	ZL201502028782.X	一种用于功率半导体器件的封装结构	斯达股份	2015.05.06	2015.11.18	原始取得	无
55	实用新型	ZL201502087126.1	一种用于功率半导体器件的封装结构	斯达股份	2015.05.06	2015.12.02	原始取得	无
56	实用新型	ZL201502087393.4	一种用于功率半导体器件的封装结构	斯达股份	2015.05.06	2015.08.26	原始取得	无
57	实用新型	ZL201502087872.2	一种用于功率半导体器件的封装结构	斯达股份	2015.05.07	2015.12.02	原始取得	无
58	实用新型	ZL201502090092.4	一种用于功率半导体器件的封装结构	斯达股份	2015.05.08	2015.12.02	原始取得	无
59	实用新型	ZL201502093472.2	一种用于功率半导体器件的封装结构	斯达股份	2015.05.08	2015.12.02	原始取得	无
60	实用新型	ZL201502093574.2	一种用于功率半导体器件的封装结构	斯达股份	2015.05.08	2015.08.26	原始取得	质押
61	实用新型	ZL2016020176336.1	一种用于功率半导体器件的封装结构	斯达股份	2016.03.09	2016.10.10	原始取得	质押
62	实用新型	ZL201602018251.5	一种用于功率半导体器件的封装结构	斯达股份	2016.03.10	2016.08.24	原始取得	质押
63	实用新型	ZL201602018251.5	一种用于功率半导体器件的封装结构	斯达股份	2017.01.22	2017.11.24	原始取得	质押
64	实用新型	ZL201710080672.7	一种用于功率半导体器件的封装结构	斯达股份	2017.01.22	2017.09.22	原始取得	质押
65	实用新型	ZL201710212746.5	一种用于功率半导体器件的封装结构	斯达股份	2017.02.13	2017.09.22	原始取得	质押
66	实用新型	ZL201712147935.9	一种用于功率半导体器件的封装结构	斯达股份	2017.11.08	2018.06.29	原始取得	无
67	实用新型	ZL201810231360.7	一种用于功率半导体器件的封装结构	斯达股份	2018.03.07	2018.10.02	原始取得	无
68	发明	ZL201710037057.4	一种用于功率半导体器件的封装结构	斯达股份	2016.03.01	2018.11.13	原始取得	